

# 中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司 募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对厦门信达股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

## 一、公司非公开发行股票募集资金情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

#### 1、2013 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202 号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向 10 名特定对象共发行了 70,634,043 股人民币普通股（A 股），发行价格为 9.72 元/股，募集资金总额为人民币 686,562,897.96 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 671,063,985.23 元。上述募集资金已于 2014 年 3 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2014]第 110803 号《验资报告》。

#### 2、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62 号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向 6 名特定对象共发行了 95,729,013 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.58 元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,996.54 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,278,147,028.63 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 26 日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2016]京会兴验字

第 62000007 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

1、2013 年非公开发行股票募集资金

单位：元

项目名称	专户银行名称	初始存放金额	利息收入净额	现金缴存金额	已使用金额	补充流动资金	存储余额
厦门 LED 封装扩建项目	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	148,971,000.00	1,567,590.18	280.00	150,537,745.25		1,124.93
安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目	招商银行股份有限公司厦门分行	373,223,585.23	5,154,294.78	1,000.00	374,113,496.16		4,265,383.85
RFID 产品设计和生产线扩建项目	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	148,869,400.00	1,404,920.01		105,026,575.42	45,247,744.59	0.00
<b>合计</b>	-	<b>671,063,985.23</b>	<b>8,126,804.97</b>	<b>1,280.00</b>	<b>629,677,816.83</b>	<b>45,247,744.59</b>	<b>4,266,508.78</b> (注 1)

2、2015 年非公开发行股票募集资金

单位：元

项目名称	专户银行名称	初始存放金额	利息收入净额	现金缴存金额	已使用金额	补充流动资金	存储余额
RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	160,000,000.00	1,490,189.92		88,802,306.22		72,687,883.70
信达光电 LED 封装扩产项目	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	618,147,028.63	7,783,772.95	430.00	348,619,326.29		277,311,905.29
信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	110,000,000.00	343,294.53	170.00	108,245,816.33		2,097,648.20
补充流动资金	兴业银行厦门湖里支行	390,000,000.00	22,100.54		390,000,055.00		22,045.54 (注 2)
<b>合计</b>	-	<b>1,278,147,028.63</b>	<b>9,639,357.94</b>	<b>600.00</b>	<b>935,667,503.84</b>		<b>352,119,482.73</b>

注 1：截至 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行股票累计使用募集资金 67,492.56 万元，已完成募集资金使用。募集资金专项账户余额 426.65 万元为利息收入及现金缴存，已于 2019 年 3 月 31 日前全部转至一般账户使用。

注 2：补充流动资金中已使用金额超出初始存放金额部分的 55.00 元系支付银行账户管理费形成，存储余额

22,045.54 元为募集资金产生的利息。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，厦门信达根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司修订了《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”）。

根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2014年4月17日，公司已与保荐机构中信建投、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。2014年5月20日，募投项目实施主体、公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年1月9日，公司已与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司湖里支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年3月16日，募投项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、广东信达光电有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公开发行股票募集资金余额为 4,266,508.78 元，具体情况如下：

单位：元

专户银行名称	账号	余额
招商银行股份有限公司厦门分行	592900001010201	4,265,383.85
招商银行股份有限公司厦门分行	592903242510801	
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040155000000028	1,124.93
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040154500000011	
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040155000000036	
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040154800000019	已注销（注 3）
<b>合计</b>	-	<b>4,266,508.78</b>

注 3：根据公司第九届董事会 2016 年第五次会议审议通过的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司在永久补充流动资金事项实施完毕后，注销该项目账户，具体内容详见《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告号：2016-50）

注 4：截至 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行股票募集资金使用完毕，公司将募集资金专项账户中留存的资金利息及现金缴存转出并办理募集资金专项账户注销。截至 2019 年 3 月 29 日，2013 年非公开发行股票相关募集资金专项账户全部注销完毕。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金余额为 352,119,482.73 元，具体情况如下：

单位：元

专户银行名称	账号	余额
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000156258	71,334,367.15
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000157940	1,353,516.55
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	360401550000000108	39,732,933.85
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040154500000020	1,808,275.47
上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	36040154500000038	235,770,695.97
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000156332	191,270.63
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000158443	7,832.84
厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	9020111010010000156651	1,898,544.73
兴业银行厦门湖里支行	129920100100255895	22,045.54
<b>合计</b>	-	<b>352,119,482.73</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

不适用。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2013 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行股票募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。

2013 年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，截至 2014 年 3 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为 13,570,481.93 元，具体情况为：(1) 厦门 LED 应用产品及封装扩建项目置换募集资金 2,082,272.50 元；(2) RFID 产品设计和生产线置换募集资金 11,488,209.43 元。2014 年 7 月 18 日，董事会会议审议过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用 2013 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,570,481.93 元。

##### 2、2015 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行股票募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，予以置换。

2015 年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，自 2015 年 6 月 9 日至 2016 年 3 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为

33,375,554.36 元，具体情况为：（1）信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目 30,615,566.35 元；（2）信达物联安防技术服务平台项目 2,759,988.01 元。2016 年 7 月 21 日，董事会会议审议过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用 2015 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 33,375,554.36 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司将 2013 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

2014 年 8 月 12 日，公司第九届董事会 2014 年度第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 9 个月。

2014 年 9 月份公司将暂时闲置的募集资金共计 27,297.10 万元用于补充流动资金。2015 年 5 月 27 日，公司已将 27,297.10 万元补充流动资金的暂时闲置募集资金全部收回并存入公司募集资金专用账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，除上述情形外，公司未有其他将闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

#### （六）节余募集资金使用情况

公司 2013 年非公开发行股票募集资金节余使用情况如下：

2016 年 7 月 21 日，公司召开了第九届董事会 2016 年度第五次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司用于投资“RFID 产品设计和生产线扩建项目”募集资金金额为 14,886.94 万元，由于“RFID 产品设计和生产线扩建项目”已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，同意公司将该募投项目节余募集资金 4,415.06 万元以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放该募投项目的募集资金专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日，上述节余

募集资金及利息合计 4,524.77 万元转为永久性补充流动资金。

本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

截至 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行股票全部募投项目投资完成，募集资金使用完毕，募集资金专项账户余额 426.65 万元为利息收入及现金缴存，公司已将上述节余资金转至一般账户使用。

本次全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

#### **（七）超募资金使用情况**

不适用。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途和去向**

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

#### **（二）变更募集资金投资项目的理由**

##### **1、2013 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况**

（1）经公司第九届董事会 2014 年度第七次会议、2014 年第四次临时股东

大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原投资于“厦门 LED 应用产品扩产项目”的募集资金投资额为 14,897.10 万元。为了提升公司 LED 封装产能及产品升级，适应封装市场发展的趋势，进一步增强公司 LED 产品的综合竞争力，公司将“厦门 LED 应用产品扩产项目”中的户外照明项目和部分实验中心扩建项目变更为封装扩建项目。项目名称由原“厦门 LED 应用产品扩产项目”变更为“厦门 LED 应用产品及封装扩建项目”，本次变更部分募集资金用途涉及金额总计 7,149.76 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的 10.65%。

经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升 LED 封装产能，进一步增强公司 LED 封装市场的综合竞争力，公司将“厦门 LED 应用产品及封装扩建项目”中的 LED 室内照明应用生产线（日光灯、球泡灯、面板灯等 3 条线）及研发中心项目变更为 LED 显示屏封装生产线。项目名称由原“厦门 LED 应用产品及封装扩建项目”变更为“厦门 LED 封装扩建项目”，本次募集资金投资项目变更涉及金额总计 6,505.00 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的 9.69%。

(2) 经公司第九届董事会 2015 年度第六次会议、2015 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原投资于“安溪 LED 封装新建项目”的募集资金投资额为 37,322.36 万元，为了加快提升室内照明光源的研发、制造与销售，增强公司 LED 封装产品的综合竞争力，公司将“安溪 LED 封装新建项目”的部分募集资金变更用于收购深圳市灏天光电有限公司 70% 股权。项目名称由原“安溪 LED 封装新建项目”变更为“安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目”，本次变更部分募集资金用途涉及金额总计 5,041.40 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的 7.51%。

(3) 经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司用于投资“RFID 产品设计和生产线扩建项目”募集资金金额为 14,886.94 万元，由于“RFID 产品设计和生产线扩建项目”已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，同意公司将该募



投项目节余募集资金 4,415.06 万元以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2018 年 12 月 31 日，上述节余募集资金及利息合计 4,524.77 万元转为永久性补充流动资金。

## 2、2015 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况

(1) 经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划投资于“信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目”的募集资金投资额为 61,814.70 万元。为了充分利用公司现有厂房和加快公司 LED 封装产能升级，进一步增强公司 LED 封装的综合竞争力，公司拟将“信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目”中的新建厂房和 LED 白光封装及应用产品生产线扩产项目变更为扩建 4 条 LED 封装产品生产线与新建 LED 产品综合实验室项目。项目名称由原“信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电 LED 封装扩产项目”，本次募集资金投资项目变更涉及金额总计 61,814.70 万元，占本次非公开发行股票募集净额的 48.36%。

(2) 经公司第十届董事会 2017 年度第三次会议、2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划于“信达物联安防技术服务平台项目”使用募集资金 16,000.00 万元。为了提升公司 RFID 电子标签产能，进一步增强公司物联网整体解决方案的综合竞争力，公司将“信达物联安防技术服务平台项目”的部分募集资金用于 RFID 产品设计和生产线的扩产，项目名称由原“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目”，本次募集资金投资项目变更涉及金额总计 14,983.99 万元及募集资金专户后期利息收入，占本次非公开发行股票募集总金额的 11.52%。

(3) 经公司第十届董事会 2018 年第二次会议、2018 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为适应 LED 封装市场发展的趋势，进一步布局并扩大高端产品市场，提升募集资金投入设备的使用效率，公司将“信达光电 LED 封装扩产项目”部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用，该部分设备原值共计 6,666.38 万元，租赁期两年，租金为

55.56 万元/月，本次募集资金投资项目用途变更占本次非公开发行股票募集总金额的 5.13%。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

根据“[2019]京会兴鉴字第 62000001 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“厦门信达股份有限公司董事会编制的《募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。”

## **七、保荐机构的核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对厦门信达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## **八、保荐机构的核查意见**

经核查，本保荐机构认为：厦门信达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，厦门信达募集资金具体情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门信达股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

2013 年非公开募集资金					2015 年非公开募集资金						
募集资金总额		67,106.40	报告期投入募 集资金总额	2,081.22	募集资金总额		127,814.70	报告期投入募 集资金总额	19,484.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			报告期内变更用途的募集资金总额		6,666.38				
累计变更用途的募集资金总额		23,114.65	已累计投入募 集资金总额	67,492.56	累计变更用途的募集资金总额		83,465.07	已累计投入募 集资金总额	93,566.75		
累计变更用途的募集资金总额比例		34.44%			累计变更用途的募集资金总额比例		65.30%				
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入 进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本期实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目											
2013 年非 公开 募集 资金	1.厦门 LED 封装扩建项目	是	14,897.10	14,897.10	678.30	15,053.78	101.05	2016 年 12 月 31 日	1,109.76	是	否
	2.安溪 LED 封装新建项目及 股权收购项目	是	38,872.25	37,322.36	1,296.64	37,411.35	100.24	2016 年 6 月 30 日	195.28	是	否
	3.RFID 产品设计和生产线扩 建项目	是	14,886.94	10,502.66		10,502.66	100.00	2016 年 6 月 30 日	245.93	是	否
	4.永久补充流动资金	否		4,418.49	106.28 (注 2)	4,524.77	102.41	不适用	不适用	不适用	不适用
2015 年非 公开 募集 资金	1.信达物联安防技术服务平 台项目	是	16,000.00	1,096.54		1,096.54	100.00	2017 年 10 月 12 日	-11.89	否	否
	2.RFID 产品设计和生产线二 期扩建项目	否		14,983.99	7,783.69	7,783.69	51.95	2019 年 12 月 31 日	-	不适用	否
	3.信达光电 LED 封装扩产项 目	是	64,000.00	61,814.70	10,558.96	34,861.93	56.40	2017 年 5 月 31 日	-60.85	否	否
	4.信达光电 LED 显示屏封装 产品扩产项目	否	11,000.00	11,000.00	1,141.60	10,824.58	98.41	2016 年 7 月 31 日	-16.63	否	否

	补充流动资金	否	39,000.00	39,000.00		39,000.01	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		-	198,656.29	195,035.84	21,565.47	161,059.31	-	-	1,461.60	-	-
超募资金投向		不适用									
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>198,656.29</b>	<b>195,035.84</b>	<b>21,565.47</b>	<b>161,059.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,461.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		信达光电 LED 封装扩产项目由于用工短缺影响投产计划进度导致投产情况未达计划进度。报告期内，公司着力推动解决人员招聘问题，但随着公司进一步扩产，用工问题依然影响投产计划进度。 显示屏封装市场价格竞争激烈，毛利率较低，导致信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目未达预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2014 年 7 月 18 日，董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,570,481.93 元。2016 年 7 月 21 日，董事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 33,375,554.36 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内无此种情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		“RFID 产品设计和生产线扩建项目”预计投资总额 15,210.94 万元，拟用募集资金投资 14,886.94 万元。2016 年 8 月 9 日，股东大会审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意用“RFID 产品设计和生产线扩建项目”节余募集资金以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2018 年 12 月 31 日，项目节余募集资金以及募集资金专户利息合计 4,524.77 万元转为永久性补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		1、安溪 LED 封装新建项目募集资金承诺投资总额由 38,872.25 万元调整为 37,322.36 万元，调整差额 1,549.89 万元系募集资金的承销费（包括保荐费）及其他发行费用扣减所致；2、信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目募集资金承诺投资总额由 64,000.00 万元调整为 61,814.70 万元，调整差额 2,185.30 万元系募集资金的承销费（包括保荐费）及其他发行费用扣减所致；3、RFID 产品设计和生产线扩建项目募集资金承诺投资总额由 14,886.94 万元调整为 10,502.66 万元，以及永久补充流动资金 4,418.49 万元，系 2016 年该募投项目节余募集资									

---

---

金连同部分利息收入变更为永久补充流动资金，该事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
---

---

---

注 1：募集资金总额超过调整后投资总额部分的主要原因为部分项目变更募集资金用途时含募投项目所产生的利息。

注 2：2013 年非公开募集资金永久补充流动资金项目，本报告期投入金额 106.28 万元，是募集资金专户利息收入转为永久性补充流动资金。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 厦门信达股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
厦门LED封装扩建项目	厦门LED应用产品扩产项目	14,897.10	678.30	15,053.78	101.05	2016年12月31日	1,109.76	是	否
安溪LED封装新建项目及股权收购项目	安溪LED封装新建项目	37,322.36	1,296.64	37,411.35	100.24	2016年06月30日	195.28	是	否
永久补充流动资金	RFID产品设计和生产线扩建项目	4,418.49	106.28	4,524.77	102.41	不适用	不适用	不适用	不适用
信达光电LED封装扩产项目	信达光电LED封装及应用产品扩产项目	61,814.70	10,558.96	34,861.93	56.40	2017年05月31日	-60.85	否	否
RFID产品设计和生产线二期扩建项目	信达物联安防技术服务平台项目	14,983.99	7,783.69	7,783.69	51.95	2019年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	133,436.64	20,423.87	99,635.52	-	-	1,244.19	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、“厦门LED应用产品扩产项目”变更为“厦门LED封装扩建项目”，主要系LED行业封装市场需求不断增长，变更可有效利用现有场地资源，解决公司LED封装产能瓶颈，提升市场占有率，扩大和稳定市场地位，提升公司竞争力。该事项历次变更已经公司第九届董事会2014年度第七次会议、2014年第四次临时股东大会，第九届董事会2016年度第五次会议，2016年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2014年8月23日，2016年7月23日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>2、“安溪LED封装新建项目”变更为“安溪LED封装新建项目及股权收购项目”，主要系LED行业照明市场需求不断增长，公司通过收购灏天光电将快速填补在LED白光封装领域的空白，有效加快公司在LED白光封装领域研发、制造及市场推广的发展，更好地保持竞争优势。该事项已经公司第九届董事会2015年度第六次会议审议通过。</p>						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			<p>过，并经 2015 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2015 年 9 月 26 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>3、“RFID 产品设计和生产线扩建项目”变更为“永久补充流动资金”：主要系由于公司在该项目实施过程中，本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，通过优化项目方案及资源配置等，有效降低项目支出，该募投项目已建设完成。经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意将该项目节余募集资金以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2016 年 7 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>4、“信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电 LED 封装扩产项目”，主要系 LED 行业封装市场需求不断增长，变更可有效利用现有场地资源，解决公司 LED 封装产能瓶颈，提升市场占有率，扩大和稳定市场地位，提升公司竞争力。该事项已经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议，2016 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2016 年 7 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>5、“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目”，主要系原项目由于终端市场和客户消费习惯还需培育，项目进度未达到预期，预计无法实现原定目标；而变更有利于扩大公司 RFID 电子标签产能，提高公司在鞋服零售行业物联网整体解决方案的开发能力，从而提高募集资金使用效率，提升市场竞争力。该事项已经公司第十届董事会 2017 年度第三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2017 年 8 月 30 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>6、公司将“信达光电 LED 封装扩产项目”部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用，主要为适应 LED 封装市场发展的趋势，进一步布局并扩大高端产品市场，提升募集资金投入设备的使用效率。该事项已经公司第十届董事会 2018 年第二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2018 年 3 月 31 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>“信达光电 LED 封装扩产项目”募集资金用途变更包含上述第 4 及第 6 项变更，本期实现效益含部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用所产生的租金收入。</p>						
			未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						
			报告期内，信达光电 LED 封装扩产项目用工短缺问题虽已逐步改善，但随着公司进一步扩产，人才储备与人员招聘问题依然影响投产计划进度。						
			变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						
			报告期内无此种情况。						



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张世举

陈昶

中信建投证券股份有限公司

2019年4月23日